

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 01 August 2018 (01.08.2018)

Information valid as of: 20 April 2020 (20.04.2020)

Report generated on: 21 April 2021 (21.04.2021)

(10) Publication number:

WO2019/187184

(43) Publication date:

03 October 2019 (03.10.2019)

(26) Publication language:

Japanese (JA)

(21) Application Number:

PCT/JP2018/026880

(22) Filing Date:

18 July 2018 (18.07.2018)

(25) Filing language:

Japanese (JA)

(31) Priority number(s):

2018-061061 (JP)

(31) Priority date(s):

28 March 2018 (28.03.2018)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

H01L 21/301 (2006.01); *C09J 7/22* (2018.01); *C09J 7/38* (2018.01)

(71) Applicant(s):

FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. [JP/JP]; 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322 (JP) (*for all designated states*)

(72) Inventor(s):

HASHIMOTO, Kosuke; c/o FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322 (JP)

SENDAI, Akira; c/o FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322 (JP)

SANO, Toru; c/o FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322 (JP)

(74) Agent(s):

MATSUSHITA, Makoto; Apuri Shinyokohama Building 5F., 2-5-19, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220033 (JP)

(54) Title (EN): SEMICONDUCTOR PROCESSING TAPE

(54) Title (FR): RUBAN DE TRAITEMENT DE SEMI-CONDUCTEUR

(54) Title (JA): 半導体加工用テープ

(57) Abstract:

(EN): A semiconductor processing tape is provided which enables obtaining sufficient thermal shrinkage in a short period of time and which enables maintaining curve width. This semiconductor processing tape 10 is characterized by comprising an adhesive tape 15 that comprises a substrate film 11 and an adhesive layer 12 formed on at least one side of the substrate film 11, wherein the adhesive tape 15 is such that the sum of the integral value calculated with the sum of the thermal deformation rate every 1°C between 40°C and 80°C measured while the temperature is rising by a thermo-mechanical property tester in a first direction, and the integral value calculated with the sum of the thermal deformation ratio every 1°C between 40°C and 80°C measured while the temperature is rising by a thermomechanical property tester in a second direction that forms a right angle with the aforementioned first direction is a negative value.

(FR): L'invention concerne un ruban de traitement de semi-conducteur qui permet d'obtenir une contraction thermique suffisante en peu de temps et de maintenir la largeur de courbe. Ce ruban de traitement de semi-conducteur (10) est caractérisé en ce qu'il comprend un ruban adhésif (15) qui comporte un film de substrat (11) et une couche adhésive (12) formée sur au moins un côté du film de substrat (11), le ruban adhésif (15) étant tel que la somme de la valeur intégrale calculée avec la somme de la vitesse de déformation thermique tous les 1 °C entre 40 °C et 80 °C mesurée par un appareil d'essai de propriétés thermomécaniques dans une première direction tandis que la température augmente, et la valeur intégrale calculée avec la somme de la vitesse de déformation thermique tous les 1 °C entre 40 °C et 80 °C mesurée par un appareil d'essai de propriétés thermomécaniques dans une seconde direction qui forme un angle droit avec la première direction susmentionnée tandis que la température augmente est une valeur négative.

(JA): 短時間で十分に加熱収縮させることができ、カーブ幅を保持することができる半導体加工用テープを提供する。
本発明の半導体加工用テープ 10 は、基材フィルム 11 と、前記基材フィルム 11 の少なくとも一面側に形成され

た粘着剤層 1 2 とを有する粘着テープ 1 5 を有し、前記粘着テープ 1 5 は、いずれかの第一の方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した 4 0 °C ~ 8 0 °C の間の 1 °C 毎の熱変形率の総和で算出される積分値と、前記第一の方向と直角をなす第二の方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した 4 0 °C ~ 8 0 °C の間の 1 °C 毎の熱変形率の総和で算出される積分値との和がマイナス値であることを特徴とする。

International search report:

Received at International Bureau: 08 October 2018 (08.10.2018) [JP]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM